

强于大市

半导体行业周报

长期看数字化叠加芯片安全，短期看芯片缺货加速国产化

行业动态：

- **IPO 动态：**86 家申报 IPO 上市辅导等，华海清科顺利过会。上周新增射频芯片企业飞驒科技上市辅导，华海清科 IPO 审核顺利过会。
- **半导体设备：**缺芯成常态，扩产瓶颈在设备。全球产能扩张主要集中在中国大陆的成熟制程，和中国台湾地区和韩国的先进制程，先进制程的技术进步和资本密度提升导致 ASML、应用材料和泛林等设备龙头的订单交付期显著拉长至三个季度以上，相比之下，国产设备再度迎来黄金发展时期，满足国内成熟制程扩产需求。长期看全球经济数字化，叠加全球芯片的产业转移，中国大陆晶圆制造地位的上升支撑国产半导体设备的长期持续成长空间。国内 CMP 设备制造商华海清科上周成功过会，2020 年收入 3.86 亿元同比增长 83%。美国应用材料官方微信公众号发布 Endura®Copper Barrier Seed IMS™ 具有在高真空条件下将 ALD、PVD、CVD、铜回流、表面处理、界面工程和计量这七种不同的工艺技术集成为一个系统的优势，产品多元化的优势值得北方华创、中微公司、盛美股份等借鉴。
- **晶圆代工：**芯片供应链安全战略加速晶圆制造产能扩张。芯片产能紧缺成为各行各业发展的掣肘，芯片供应链安全成为欧美日的重点考量，全球芯片产业的地域分布从专业分工发展到自建晶圆产能保障芯片安全，去年 5 月台积电宣布将在美国亚利桑那州投资 120 亿美元新建 12 英寸 5nm 晶圆厂，预计在 2024 年建成投产。
- **封测：**京元电子已有超过百名员工重返工作岗位可望减缓对 6 月营收的冲击，利扬芯片引进中国大陆第 1 台 V93000 EXA SCALE 测试设备。据财联社报道，自 6 月 14 日中国台湾京元电子竹南厂区有外籍员工发生群体感染事件导致京元电子生产线人力大减后，6 月 18 日京元电子已证实公司所有外籍员工经过多次筛检后，经疾管局、指挥中心许可，有超过百名员工重返工作岗位。6 月 2 日，新一代 V93000 EXA Scale 在广东利扬芯片完成安装，作为爱德万测试的全新机型，V93000 EXA Scale 自 2020 年 9 月正式发布，此为在中国大陆用户处的第 1 台装机。
- **功率半导体：**全球功率半导体厂商 6 月陆续涨价。多家功率半导体厂商在近期发布了涨价通知，ST 宣布全系列产品于 6 月 1 日开始涨价；安森美宣布部分产品价格上调，生效日期定于 7 月 10 日。功率半导体龙头英飞凌公告称，因受马来西亚持续封锁影响，马六甲封测厂损失 2-3 周产能，6 月中旬新一轮产品涨价，MOSFET 的涨幅将有 12%。
- **MCU：**据报道我国汽车芯片自给率不足 5%，其中 MCU 最为紧缺也最薄弱，乐观预测汽车芯片短缺下半年可缓解。6 月 19 日举行的 2021 中国汽车论坛上，中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶盛基介绍称，我国各类芯片中 MCU 控制芯片最为紧缺，国内相关企业也最为薄弱。目前中国半导体自给率为 15%，而其中汽车芯片自给率不足 5%。预测今年第二季度汽车芯片短缺将达到最高峰，乐观预计汽车芯片短缺情况将在今年下半年开始缓解。

投资建议：

- **设备组合：**中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技、晶盛机电
- **材料组合：**雅克科技、沪硅产业、中环股份；
建议关注：安集科技、立昂微、彤程新材、晶瑞股份
- **功率半导体组合：**斯达半导、新洁能、华润微；
建议关注：士兰微、闻泰科技
- **模拟：**圣邦股份；
建议关注：思瑞浦、卓胜微（射频）
- **MCU：**兆易创新；
建议关注中颖电子
- **其他：**韦尔股份；
建议关注：三安光电、乐鑫科技、恒玄科技

风险提示

- 疫情影响超预期；半导体设备国产化进程放缓；美国进一步向中国禁售关键半导体设备。

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格

半导体

证券分析师：杨绍辉

(8621)20328569

shaohui.yang@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300514080001

证券分析师：余媛媛

(8621)20328550

yuanyuan.yu@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300517050002

证券分析师：王达婷

(8621)20328284

dating.wang@bocichina.com

证券投资咨询业务证书编号：S1300519060001

目录

拟 IPO 的半导体企业汇总	3
图表 1. 半导体拟 IPO 统计表（截止 2021/06/20）	3
续 图表 1. 半导体拟 IPO 统计表（截止 2021/06/20）	4
上周信息汇总	5
半导体设备	5
半导体材料	5
EDA&IP 服务	6
晶圆代工	7
封测	7
功率半导体	7
模拟电路	8
射频芯片	8
MCU	9
风险提示	10

拟 IPO 的半导体企业汇总

截止 2021/6/20，共有 86 家半导体企业申报 IPO、开展上市辅导等。其中，上周新增射频芯片企业飞驒科技上市辅导，华海清科 IPO 审核顺利过会。

图表 1. 半导体拟 IPO 统计表（截止 2021/06/20）

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
1	气派科技	正在发行	华创证券	2006	封测	SOP、SOT 等传统封装
2	格科微	已注册	中金公司	2003	设计	CMOS 图像传感器、显示驱动芯片
3	力芯微	已注册	光大证券	2002	设计	MCU、高压模拟电路、数模混合信号
4	复旦微	已注册	中信建投	1998	设计	FPGA、RFID 芯片、智能卡芯片、EEPROM、智能电表 MCU
5	艾为电子	已注册	中信证券	2008	设计	高品质数模混合信号、模拟、射频
6	宏微科技	提交注册	民生证券	2006	设计	以 IGBT、FRED 为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组
7	盛美股份	提交注册	海通证券	2005	设备	清洗设备、FN、镀铜设备等
8	灿勤科技	提交注册	中信建投	2004	设计	微波介质陶瓷元器件
9	普冉股份	提交注册	中信证券	2016	设计	超低功耗 Flash 存储器、高安全 Flash 存储器、高可靠性 EEPROM 存储器
10	雷微电子	提交注册	中信证券	2007	设计	高性能微波及射频 SOC 集成电路
11	中车电气	提交注册	中金公司	2005	设计	功率半导体
12	炬芯科技	过会	申万宏源	2014	设计	蓝牙音频 SoC 芯片、便携式音视频 SoC 芯片、智能语音交互 SoC 芯片等
13	东芯股份	过会	海通证券	2014	设计	24nm NAND、48nm NOR
14	华海清科	过会	国泰君安	2013	设备	CMP 设备
15	安路科技	问询	中金公司	2011	设计	可编程逻辑器件 (FPGA)、可编程系统级芯片 (SoC)、及相关 EDA 软件工具和创新系统解决方案
16	芯导科技	问询	国元证券	2009	设计	功率
17	翱捷科技	问询	海通证券	2015	设计	全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片
18	华卓清科	问询	东兴证券	2012	零部件	光刻机双工件台
19	中图科技	问询	申万宏源	2013	材料	图形化蓝宝石衬底
20	【苏州】国芯科技	问询	国泰君安	2001	设计	国产自主 32 位高性能嵌入式 CPU 开发、嵌入式产品设计和推广应用
21	瑞能半导	问询	中信证券	2015	设计	碳化硅二极管，可控硅整流器和三端双向可控硅、功率二极管、高压晶体管
22	云天励飞	问询	中信证券	2014	设计	AI 芯片
23	德明利	已申报	东莞证券	2008	设计	闪存主控芯片，存储模组产品应用方案
24	英集芯科技	已申报	华泰联合	2014	设计	数模混合集成电路芯片
25	博蓝特半导体	已申报	渤海证券	2012	设计	GaN 基 LED 芯片（图形化）衬底及第三代半导体材料
26	希荻微	已申报	民生证券、中金公司	2012	设计	高性能模拟集成电路
27	麦斯克	已申报	国泰君安	1995	材料	硅片
28	天岳先进	已申报	海通证券	2010	材料	半绝缘型和导电型碳化硅衬底
29	纳芯微	已申报	光大证券	2013	设计	车规级传感器及信号链芯片
30	晶合集成	已申报	中金公司	2015	设计	面板驱动芯片
31	必易微	已申报	申万宏源	2009	设计	高性能模拟及混合信号集成电路
32	东微半导体	已申报	中金公司	2008	设计	高性能功率器件
33	思科瑞	已申报	中国银河证券	2014	测试	分立器件及晶圆测试
34	江波龙	已申报	中信建投	1999	设计	嵌入式存储、固态硬盘存储、微存储、汽车存储等
35	甬矽电子	完成上市辅导	平安证券	2019	封测	封测
36	唯捷创芯	完成上市辅导	中信建投	2010	设计	射频前端及高端模拟芯片
37	思特威	完成上市辅导	中信建投	2011	设计	CMOS 图像传感器芯片
38	概伦电子	完成上市辅导	招商证券	2010	软件	EDA 软件
39	华大九天	完成上市辅导	中信证券	2009	软件	EDA 软件
40	金海通	完成上市辅导	海通证券	2012	设备	高温 IC 自动测试 Pick-Place 分选机

资料来源：万得、爱集微、中银证券

续 图表 1. 半导体拟 IPO 统计表 (截止 2021/06/20)

序号	公司	最新进度	保荐机构	成立时间	类别	核心业务
41	峰昭科技	完成上市辅导	海通证券	2010	设计	电机驱动控制芯片
42	辉映微	完成上市辅导	海通证券	2016	设计	MEMS 非制冷热电堆红外传感器
43	天德钰	完成上市辅导	中信证券	2010	设计	智能移动终端显示屏驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片、快速充电协议芯片、电子价签驱动芯片及解决方案
44	艾森半导体	上市辅导	华泰联合	2010	材料	光刻胶及配套高纯化学品
45	芯愿景	上市辅导	民生证券	2002	软件	EDA 软件
46	江苏影速	上市辅导	中金公司	2014	设备	激光直写的光刻机设备
47	上海微	上市辅导	中信建投	2002	设备	光刻机
48	矽电半导体	上市辅导	招商证券	2003	设备	探针台
49	中科飞测	上市辅导	国泰君安	2014	设备	量测设备
50	海光信息	上市辅导	中信证券	2014	设计	CPU
51	龙腾半导体	上市辅导	国信证券	2009	设计	新型功率半导体器件
52	龙芯中科	上市辅导	中信证券	2010	设计	CPU
53	苏州赛芯	上市辅导	国泰君安	2009	设计	模拟芯片
54	芯龙半导体	上市辅导	海通证券	2007	设计	电源管理类模拟集成电路
55	中微股份	上市辅导	中信证券	2001	设计	混合信号 SoC
56	比亚迪半导体	上市辅导	中金公司	2004	设计	功率半导体
57	广立微	上市辅导	中金公司	2003	软件	EDA 软件、电路 IP、晶圆级电性测试设备
58	炬光科技	上市辅导	中信建投	2007	设计	高功率半导体激光器及微光学相关产品
59	耐科装备	上市辅导	国元证券	2005	设备	半导体封装装备
60	上海伟测	上市辅导	平安证券	2016	测试	晶圆测试和芯片成品测试
61	芯动联科	上市辅导	中信建投	2012	设计	MEMS
62	芯微电子	上市辅导	国金证券	1998	设计	功率半导体分立器件
63	长光华芯	上市辅导	华泰联合	2012	设计	高功率半导体激光器芯片等
64	禹龙通	上市辅导	招商证券	2005	设计	大功率射频电阻, 同轴负载、衰减器、波导无源器件、碳化硅及橡胶板吸波材料
65	吉莱电子	上市辅导	长江证券	2001	设计	单、双向晶闸管全系列, 低频功率三极管、单、双向 TVS 保护管、双向 (防静电) 放电管
66	毓昌科技	上市辅导	国信证券	2010	设计	微波毫米波射频芯片
67	微导纳米	上市辅导(二次)	中信证券	2015	设备	原子层沉积 (ALD) 和反应离子刻蚀 (RIE) 装备
68	富创精密	上市辅导	中信证券	2008	零部件	半导体设备精密零部件加工制造及表面处理
69	源杰半导体	上市辅导	国泰君安	2013	设计	激光器芯片
70	【杭州】国芯科技	上市辅导	中信证券	2001	设计	数字电视芯片、面向物联网人工智能芯片
71	新顺微电子	上市辅导	华泰联合	2002	设计	功率半导体
72	微源半导体	上市辅导	海通证券	2010	设计	电源管理芯片
73	芯龙半导体	上市辅导	海通证券	2012	设计	电源管理类模拟集成电路
74	南麟电子	上市辅导	国金证券	2004	设计	模拟和数模混合类集成电路的设计与研究
75	国微思尔芯	上市辅导	中金公司	2003	软件	EDA
76	芯天下	上市辅导	中信建投	2014	设计	NOR Flash
77	灿芯半导体	上市辅导	海通证券	2008	软件	定制化芯片 (ASIC) 设计方案提供商及 IP 供应商
78	杰华特	上市辅导	中信证券	2013	设计	电源管理芯片
79	吉莱电子	上市辅导	长江证券	2001	IDM	功率 IDM
80	安凯微电子	上市辅导	东方证券	2000	设计	物联网摄像机核心芯片、蓝牙芯片以及应用处理器芯片
81	易兆微	上市辅导	海通证券	2014	设计	短距离无线通讯芯片
82	辉芒微	上市辅导	中信证券	2005	设计	非易失性存储芯片(NVM)、数模混合信号设计、高端模拟电路、高压电源管理芯片
83	飞驒科技	上市辅导	中金公司	2015	设计	射频芯片
84	通美晶体	上市辅导	海通证券	1998	材料	砷化镓、磷化铟等在内的 III-V 族化合物及单晶锗半导体衬底材料
85	蕊源半导体	上市辅导	中金公司	2016	设计	电源管理
86	上海超硅	上市辅导	中金公司	2008	材料	大硅片

资料来源: 万得、爱集微、中银证券

上周信息汇总

半导体设备

【中微公司】首台8英寸CCP刻蚀设备付运，发布高性能Mini-LED量产用MOCVD设备，中微临港产业化基地（一期）项目开工

6月15日公司首台8英寸甚高频去耦合反应离子CCP刻蚀设备Primo AD-RIE 200™顺利付运客户生产线，可灵活配置多达三个双反应台的反应腔（即六个反应台），并提供可选升级至12英寸刻蚀设备系统的解决方案，灵活应对产线未来扩张的需求，刻蚀设备产品矩阵逐步差异化。

6月17日公司推出专为高性能Mini-LED量产设计的Prismo UniMax™ MOCVD设备，可满足Mini-LED生产所需的优异波长均匀性、重复性、产出稳定性等关键因素，是目前国内外极具创新性的MOCVD设备。且在同一系统中可配备多达4个反应腔，通过最优化排布石墨盘晶片，其加工容量可延伸至164片4英寸或72片6英寸晶片的生长，且可通过超大直径石墨托盘降低生产成本。创新产品的推出将有力带动公司在MOCVD领域内抢夺市场份额，继续提升竞争力。

6月20日上海自贸区临港新片区第二季度建设工程集中开工，含中微临港产业化基地（一期）项目等12个项目，总投资224亿元。其中，中微临港产业化基地（一期）项目规划总建筑面积约180000平方米，总投资约15亿，预计2022年12月建成。将满足中微集成电路、泛半导体设备的研发、测试和产业化需求。

（资料来源：中微公司微信公众号）

【华海清科】国内高端CMP设备制造先锋成功通过科创板IPO审核

6月17日，上海证券交易所科创板上市委员会召开2021年第39、40次上市委员会审议会议，此次会议审核了华海清科股份有限公司等4家公司并顺利过会。

华海清科是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商，主要产品为化学机械抛光(CMP)设备。CMP是先进集成电路制造前道工序、先进封装等环节必需的关键制程工艺，该公司所生产CMP设备可广泛应用于12英寸和8英寸的集成电路大生产线，产品总体技术性能已达到国内领先水平。

（资料来源：万得、电鳗快报）

【行业】美国应用材料全新先进逻辑芯片布线工艺技术，可微缩至3纳米以下技术节点

6月17日美国应用材料公司在其官方微信公众号上推出了一种名为Endura®Copper Barrier Seed IMS™的全新材料工程解决方案。在高真空条件下将ALD、PVD、CVD、铜回流、表面处理、界面工程和计量这七种不同的工艺技术集成到一个系统中。

其中，ALD选择性沉积取代了ALD共形沉积，省去了原先的通孔界面处高电阻阻挡层。解决方案中还采用了铜回流技术，可在窄间隙中实现无空洞的间隙填充。通过这一解决方案，通孔接触界面的电阻降低了50%，芯片性能和功率得以改善，逻辑微缩也得以继续至3纳米及以下节点。

（资料来源：美国应用材料官方微信公众号）

半导体材料

【中环股份】拟斥3.9亿元向控股子公司中环领先增资，提升半导体材料产业市场覆盖率

6月20日公司发布公告称，为了进一步落实公司产业发展规划及战略布局，各股东方向中环领先合计增资13亿元。其中公司增资3.9亿元、浙江晶盛机电股份有限公司增资1.3亿元。将促使公司的半导体材料产业市场覆盖率上升、产品产销扩大和盈利能力提高，对公司高速可持续发展产生长期积极作用。

（资料来源：万得、智通财经）

【楚江新材】将紧紧围绕半导体材料的“四高两涂”储备技术进行布局

6月15日公司在投资者互动平台回应投资者6月11日问到公司的第三代半导体方面布局情况，表示公司将紧紧围绕半导体材料的“四高两涂”储备技术进行布局（高纯碳粉、碳化硅单晶、高纯碳化硅专用高纯热场、高纯石墨、碳化硅涂层、碳化钽涂层）。

（资料来源：万得）

【上海新阳】完成发行1亿元中期票据，部分光刻胶产品正在上线测试中

6月17日公司发布公告称，于2021年6月15日至16日发行了2021年度第一期中期票据（高成长债），发行总额人民币1亿元（票面利率3.8%），兑付日为2022年06月22日。同时，公司在投资者互动平台回应投资者问到光刻胶产品的测试进度，表示部分光刻胶产品正在上线测试中。

（资料来源：万得）

【沪硅产业】参股成立科技发展新公司，注册资本6亿元

6月17日企查查APP显示上海新汇智源科技发展有限公司成立，股权穿透显示，该公司由沪硅产业（688126）、上海嘉定工业区开发（集团）有限公司、上海新微科技集团有限公司共同持股，注册资本6亿元人民币。资料显示从事范围包括：半导体技术、集成电路技术、电子技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等；

（资料来源：万得）

【安集科技】国家大基金减持1%，当前仍占公司总股本的10.57%

6月17日公司公告称收到股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称“国家集成电路基金”）发来的《关于股东减持结果告知函》，其于2021年2月22日-6月16日通过集合竞价方式减持公司股份53.1083万股，占公司总股本的1%。当前国家集成电路基金持有公司股份561.3489万股，占公司总股本的10.57%。

（资料来源：万得、格隆汇）

【深南电路】拥有深圳2家、无锡1家封装基板工厂，产能可分别达到30/60万平方米/年

6月17日公司在投资者互动平台回应投资者6月14日对公司目前基板产能情况的提问，表示共拥有深圳2家、无锡1家封装基板工厂，深圳封装基板工厂设计年产能约30万平方米/年，目前产能利用率保持较高水平；无锡封装基板工厂于2019年6月连线生产，目前产能爬坡进展顺利，预计达产后新增产能60万平方米/年。公司封装基板业务2020年实现营业收入15.44亿元，占公司营业总收入13.31%。

（资料来源：万得）

EDA&IP 服务

【芯原股份】将参与即将开幕的RISC-V中国峰会，在RISC-V领域进行了股权投资布局

6月17日公司在投资者互动平台表示，将参与即将开幕的RISC-V中国峰会，参与形式包括策划和主持“RISC-V产业及生态发展”和“RISC-V教育及软件生态”两场圆桌论坛，发表“RISC-V，智慧物联网创新发展”主题演讲，以及现场设置展台展示公司技术和解决方案。

2018年9月，受上海市经信委推荐，芯原作为首任理事长单位，与上海集成电路行业协会协作，联合数十家国内RISC-V领域重点企业和科研院所、投资机构等成立中国RISC-V产业联盟，联盟迄今已发展了百余家会员，对于新兴技术的应用和国产芯片的进步起到了较大的推动作用。同时，公司也在RISC-V领域进行了股权投资等布局。

（资料来源：金融界、同花顺金融研究中心）

晶圆代工

【行业】传晶圆代工成熟制程Q3报价最高将上调三成，远高于市场预期的15%

据台湾经济日报报道，晶圆代工成熟制程供不应求盛况加剧，传出第三季报价最高将上调三成，远高于市场预期的15%。其中，联华电子、力积电最受客户追捧，价格涨势最大，台积电、世界先进也将因应市况而有所调整。中国台湾近期连遭冲击，从疫情、缺水到停电，都对芯片生产进一步造成干扰，联华电子6月14日强调，今年平均销售价格(ASP)将有双位数增长；力积电董事长黄崇仁此前也公开表示，半导体晶圆代工价格每季都在涨且没有下来的迹象，若IC设计客户毛利率超过晶圆代工厂，则力积电会跟涨。

(资料来源：台湾经济日报)

封测

【捷捷微电】有少量碳化硅器件的封测，尚未进入量产阶段

6月17日捷捷微电在投资者互动平台回应投资者对公司在第三代半导体的布局情况，表示目前有少量碳化硅器件的封测，该系列产品仍在持续研究推进过程中，尚未进入量产阶段。

(资料来源：万得)

【通富微电】具备封测第三代碳化硅半导体的能力，已有3D封测技术布局

6月18日通富微电在投资者互动平台回应投资者对于公司是否有第三代碳化硅半导体封测业务 AMD 3D V-Cache 产品封测业务的询问，表示公司具备封测第三代碳化硅半导体的能力，坚持以集成电路封测为主业，已有相关3D封测技术布局。

(资料来源：万得)

【深康佳A】正在尽快推进盐城半导体封测基地项目

6月17日深康佳在投资者互动平台回应6月16日投资者对盐城项目进度的询问，表示正在尽快推进盐城半导体封测基地项目。

(资料来源：万得)

【行业】京元电子已有超过百名员工在6月18日重返工作岗位，望减缓6月营收冲击

6月14日京元电子竹南厂区有外籍员工发生群体感染事件，导致京元电子生产线人力大减。6月18日京元电子已证实公司所有外籍员工经过多次筛检后，经疾管局、指挥中心许可，已有超过百名员工在今日重返工作岗位，可望减缓对6月营收的冲击。

(资料来源：财联社、科创板日报)

功率半导体

【派瑞股份】竞得西安相关地块作“大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目”实施用地

6月20日派瑞股份发布公告称取得了与西安市自然资源和规划局签订的《GX3-29-41国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》，确认公司竞得宗地号为GX3-29-41的国有建设用地使用权。拟将此次成功竞得使用权的土地作为公司募集资金投资项目“大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目”的实施用地，从而尽快推进募投项目建设。

(资料来源：万得、格隆汇)

【台基股份】第三代宽禁带半导体材料和器件技术，尚未形成产品

6月17日台基股份在投资者互动平台表示公司跟踪和研发以SiC（碳化硅）和GaN（氮化镓）为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术，尚未形成产品。

（资料来源：万得、每日经济新闻）

【斯达半导】修订非公开发行A股股票预案，强调“高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目”和“SiC芯片研发及产业化项目”

6月17日斯达半导发布修订非公开发行A股股票预案公告，将原募投项目相关内容中的“高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目”分拆为“高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目”和“SiC芯片研发及产业化项目”。突出分开区别两个项目。

（资料来源：万得）

【行业】全球功率半导体厂商6月陆续涨价，英飞凌：受马来西亚持续封锁影响，马六甲封测厂损失2-3周产能，正在酝酿新一轮产品涨价

多家功率半导体厂商在近期发布了涨价通知，ST宣布全系列产品于6月1日开始涨价；安森美宣布部分产品价格上调，生效日期定于7月10日。

6月15日英飞凌向客户发布通知称，受全球新冠疫情（COVID-19）再度爆发的影响，马来西亚政府已经于6月11日宣布将“全面行动管制令”在6月14日到期后再延长两周至6月28日，不过，其马六甲封测厂和Kulim晶圆制造和测试工厂已被授予基本工业地位，因此被允许持续运营。由于所有生产区域的消毒、员工检疫和全面PCR检测等安全措施，将导致在接下来的几天内，现场工作人员将非常有限。预计将会有2-3周的累积产能损失，正酝酿6月中旬新一轮产品涨价，MOSFET的涨幅将有12%。

（资料来源：万得、中电网、集微网）

模拟电路

【晶丰明源】筹划以发行股份、支付现金方式购买参股公司“南京凌鸥创芯电子有限公司”的部分股权，同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金

6月18日晶丰明源发布公告称上海晶丰明源半导体股份有限公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买参股公司南京凌鸥创芯电子有限公司的部分股权，同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司股票将于6月21日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

（资料来源：万得，科创板日报）

射频芯片

【信维通信】已为智能家居等终端设备提供天线、无线充电、EM/EMC器件等产品；有5G车联网天线系统等相关专利；毫米波通讯网络大规模普及还需时日；不存在无线充电接收端在北美大客户的份额下降的情况

6月14日-20日信维通信在投资者互动平台积极回复投资者的询问，表示如下：

- 公司BTB连接器业务在客户端已取得较好突破，有信心进一步扩大相关业务规模；
- 公司目前与知名芯片厂商保持在UWB领域的较深合作，为客户提供多种形式的产品开发方案；
- 公司电阻业务尚处于发展初期，正在按照项计划推进建设实施；
- 公司有有5G车联网天线系统等相关专利；
- 公司产品可广泛应用于各种智能终端，包括智能家居、智能穿戴、智能音箱等；

- 公司主要向国内客户提供小基站天线产品，目前相关业务营收占比较小；
- 华为是公司的重要合作对象，公司为其提供天线、无线充电模组、EMI/EMC 等泛射频产品，但与其未有汽车领域的产品提供；
- 公司目前已与上汽大众等汽车厂商形成合作；
- 公司已为智能家居等终端设备提供天线、无线充电、EMI/EMC 器件等产品；
- 公司在北京、深圳、常州、越南等地设有生产制造基地；
- 不存在无线充电接收端在北美大客户的份额下降的情况；
- 国内大部分移动终端产品采用 LDS 方案。公司正积极为国内外客户配套新的 LCP 天线项目开发；
- 全球已经有部分国家与地区商用毫米波通讯，但就目前整体终端市场而言，毫米波通讯网络覆盖相对较少，大规模普及还需时日。

(资料来源：万得)

【硕贝德】已进入全球主要手机厂商供应链

6月15日硕贝德在投资者互动平台回应投资者对于公司是否有关联方在苹果2020年Top200供应商名单的询问，表示公司已进入全球主要手机厂商供应链。

(资料来源：万得)

【麦捷科技】去年Q4中高端客户订单上涨，低端市场库存消化变慢

6月15日麦捷科技在投资者互动平台回应，去年四季度上涨过快的订单主要是中高端客户订单，因此库存中低端市场库存消化反而变慢。

(资料来源：万得)

MCU

【行业】中汽协叶盛基：我国汽车芯片自给率不足5%，MCU最为紧缺也最薄弱；乐观预测汽车芯片短缺下半年缓解

6月19日举行的2021中国汽车论坛上，中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶盛基介绍称，当前，我国各类芯片中MCU控制芯片最为紧缺，国内MCU控制芯片企业最为薄弱。目前中国半导体自给率为15%，其中汽车芯片自给率不足5%。当前汽车芯片供应缺口、恢复周期等信息的不清晰，市场上出现芯片分销商囤货居奇、漫天要价情况。同时，企业也选择大量囤货扫货，提高芯片库存，来抵御未来的风险，进一步加剧了当前芯片短缺困境。预测今年第二季度汽车芯片短缺将达到最高峰，乐观预计汽车芯片短缺情况将在今年下半年开始缓解。当汽车行业不缺芯片后，其他行业再经过半年周期性调整，预计到2022年年底整个半导体产业供应将恢复平衡。

(资料来源：万得、每日经济新闻)

风险提示

疫情影响超预期：新冠疫情仍处于全球蔓延阶段，若新冠疫情影响超预期，可能造成全球系统性风险及行业需求不达预期风险。

半导体设备国产化进程放缓。新一轮设备采购中，因进口品牌已深切感受到来自国产设备替代进口设备的经营压力，进口品牌可能通过降价压制国产设备扩大市场份额。

美国进一步向中国禁售关键半导体设备。由于本土晶圆厂对美国设备的依赖度接近 50%，因此一旦美国对出口至我国的关键半导体设备进行约束，我国本土晶圆厂的建产进度将受到影响。

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

- 买入：预计该公司股价在未来 6 个月内超越基准指数 20%以上；
- 增持：预计该公司股价在未来 6 个月内超越基准指数 10%-20%；
- 中性：预计该公司股价在未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；
- 减持：预计该公司股价在未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上；
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

- 强于大市：预计该行业指数在未来 6 个月内表现强于基准指数；
- 中性：预计该行业指数在未来 6 个月内表现基本与基准指数持平；
- 弱于大市：预计该行业指数在未来 6 个月内表现弱于基准指数。
- 未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1)基金、保险、QFII、QDII等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2)中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人士，或将此报告全部或部分公开发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东
银城中路200号
中银大厦39楼
邮编200121
电话:(8621)68604866
传真:(8621)58883554

相关关联机构：

中银国际研究有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话:(852)39886333
致电香港免费电话：
中国网通10省市客户请拨打：108008521065
中国电信21省市客户请拨打：108001521065
新加坡客户请拨打：8008523392
传真:(852)21479513

中银国际证券有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话:(852)39886333
传真:(852)21479513

中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区
西单北大街110号8层
邮编:100032
电话:(8610)83262000
传真:(8610)83262291

中银国际(英国)有限公司

2/F,1Lothbury
LondonEC2R7DB
UnitedKingdom
电话:(4420)36518888
传真:(4420)36518877

中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道1045号
7BryantPark15楼
NY10018
电话:(1)2122590888
传真:(1)2122590889

中银国际(新加坡)有限公司

注册编号199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话:(65)66926829/65345587
传真:(65)65343996/65323371